

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年10月6日 (06.10.2005)

PCT

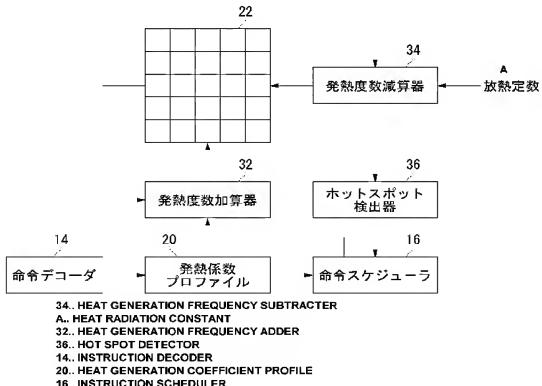
(10) 国際公開番号
WO 2005/093569 A1

(51) 国際特許分類 ⁷ :	G06F 9/50, 9/30		COMPUTER ENTERTAINMENT INC.) [JP/JP]; 〒1070062 東京都港区南青山二丁目 6 番 21 号 Tokyo (JP).
(21) 国際出願番号:	PCT/JP2004/019208		
(22) 国際出願日:	2004年12月22日 (22.12.2004)		(72) 発明者; および
(25) 国際出願の言語:	日本語		(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 安達 健一 (ADACHI, Kenichi) [JP/JP]; 〒1070062 東京都港区南青山二丁目 6 番 21 号 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内 Tokyo (JP). 矢澤 和明 (YAZAWA, Kazuaki) [JP/JP]; 〒1070062 東京都港区南青山二丁目 6 番 21 号 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内 Tokyo (JP). 潤口 巍 (TAKIGUCHI, Iwao) [JP/JP]; 〒1070062 東京都港区南青山二丁目 6 番 21 号 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内 Tokyo (JP). 今井 敦
(26) 国際公開の言語:	日本語		
(30) 優先権データ:	特願2004-096410 2004年3月29日 (29.03.2004) JP		
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント (SONY			

/ 続葉有 /

(54) Title: PROCESSOR, MULTIPROCESSOR SYSTEM, PROCESSOR SYSTEM, INFORMATION PROCESSING DEVICE, AND TEMPERATURE CONTROL METHOD

(54) 発明の名称: プロセッサ、マルチプロセッサシステム、プロセッサシステム、情報処理装置および温度制御方法



(57) Abstract: An instruction decoder (14) specifies a computing block and a heat generation coefficient concerning execution of an each instruction and stores them in a heat generation coefficient profile (20). An instruction scheduler (16) schedules instructions depending on the data dependence relation. A heat generation frequency adder (32) cumulatively adds the heat generation coefficient to the heat generation frequency of the relevant computing block held in a computing block heat generation frequency register (22) in accordance with the progress of the scheduled instructions. A heat generation frequency subtracter (34) subtracts the heat generation frequency of each computing block of the computing block heat generation frequency register (22) on the basis of the amount of heat radiated with time passage. Hot spot detector (36) detects, as a hot spot, a computing block where the heat generation frequency of the computing block heat generation frequency register (22) exceeds a predetermined threshold. The instruction scheduler (16) delays the execution of the instruction which the computing block judged as a hot spot executes.

(57) 要約: 命令デコーダ 14 は、命令毎に命令の実行に關わる演算ブロックと発熱係数を特定し、発熱係数プロファイル 20 に格納する。命令スケジューラ 16 は、命令をデータ依存関係にもとづきスケジューリングする。発熱度数加算器 32 は、スケジュールされた命令の進行に合わせて、演算ブロック発熱度数レジスタ 22 に保持されている該当する演算ブロックの発熱度数に発熱係数を累積加算する。発熱度数減算器 34 は、演算ブロック発熱度数レジスタ 22 の各演算ブロックの発熱度数を時間経過による放熱量にもとづいて減算する。ホットスポット検出器 36 は、演算

WO 2005/093569 A1

/ 続葉有 /



彦 (IMAI, Atsuhiko) [JP/JP]; 〒1070062 東京都港区南青山二丁目 6 番 21 号 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内 Tokyo (JP). 田村 哲司 (TAMURA, Tetsuji) [JP/JP]; 〒1070062 東京都港区南青山二丁目 6 番 21 号 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 森下 賢樹 (MORISHITA, Sakaki); 〒1500021 東京都渋谷区恵比寿西 2-11-12 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ヨーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 國際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドノート」を参照。

明細書

プロセッサ、マルチプロセッサシステム、プロセッサシステム、情報処理装置および温度制御方法

技術分野

[0001] この発明はプロセッサ技術に関し、特に発熱量を制御することのできるプロセッサ、マルチプロセッサシステム、プロセッサシステム、情報処理装置、および温度制御方法に関する。

背景技術

[0002] LSI設計において製造プロセスの微細化と素子の高集積化が一段と進み、チップの性能限界として発熱量を考慮することが設計上非常に重要になってきている。チップが高温になると、動作不良を起こしたり、長期信頼性が低下するため、様々な発熱対策がとられている。たとえば、チップの上部に放熱フィンを設けて、チップから発生する熱を逃がす方法がとられる。

[0003] また、チップ上の消費電力分布は一様ではないため、チップの一部が異常に高温になるいわゆる「ホット・スポット」の問題を避けることができない。そこで、チップの消費電力分布にもとづいて、プロセッサのタスクをスケジューリングすることも検討されている(たとえば、特許文献1参照)。

特許文献1:米国特許出願公開第2002/0065049号明細書

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0004] チップの一部が発熱すると、時間経過とともに熱伝導により発熱箇所の周囲に高温領域が広がり、やがてはチップ全体の温度が上昇する。従来の発熱対策は、チップ全体の温度分布を巨視的に観測し、数秒～1分程度の時間をかけて放熱するものであり、時間応答性はよくない。最近の高集積化したLSIの中には、1チップでも数十ワット程度の電力を消費するものも設計されており、数十マイクロ秒のオーダーで放熱処理をしなければ、急峻な温度上昇によって動作不良が起こりうる。局所的に発熱しているが、チップ全体としては安全な温度にあるという場合に、チップの動作周波数

を下げるに、プロセッサ全体の処理性能を犠牲にすることになり、効率的ではない。こうした状況の下、本出願人は、チップの一部が発熱した場合、熱伝導により高温領域が広がる前に、ピンポイントで発熱箇所を検出し、それ以上の温度上昇を抑える微視的なレベルでの発熱対策の必要性を認識するに至った。

[0005] 本発明はこうした課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、チップ発熱量を時間的にも空間的にも微細なレベルで制御することのできるプロセッサ、マルチプロセッサシステム、プロセッサシステム、情報処理装置、および温度制御方法を提供することにある。

課題を解決するための手段

[0006] 本発明のある態様はプロセッサに関する。このプロセッサは、発熱制御対象となる複数のブロックの発熱度数を保持する発熱度数保持部と、命令の実行に関わるブロックとそのブロックの発熱量に係る発熱係数とを所定の命令単位で特定する発熱特定部と、実行すべき命令の進行に合わせて前記所定の命令単位で、前記発熱特定部により特定されたブロックの前記発熱度数を前記発熱係数をもとに累積加算する発熱度数加算部とを含む。

[0007] 「ブロック」は、プロセッサの領域を分けた最小単位であり、スポット的に熱のピークが発生する領域の大きさに合わせて分けられる。たとえば、ブロックは、プロセッサを構成するトランジスタなどの素子単体であってもよく、ある程度の数の素子の集合であってもよい。複数のプロセッサを含むマルチプロセッサシステムの場合、ブロックは、個々のプロセッサ内で分けられたブロックであってもよく、個々のプロセッサ全体を1つのブロックとしてもよい。

[0008] 「命令単位」は、命令コードの1ステップであってもよく、命令ステップがいくつか集まって構成されるサブルーチンもしくはタスクであってもよい。

[0009] 「ブロック」の大きさおよび「命令単位」の粒度については、発熱制御の要求精度やプロセッサの設計条件などにより設計の自由度がある。

[0010] 本発明の別の態様もプロセッサに関する。このプロセッサは、発熱制御対象となる複数のブロックの発熱度数を保持する発熱度数保持部と、所定の命令単位で見積もられた発熱量をもとに、命令の進行に合わせて前記所定の命令単位で前記命令の

実行に関わるブロックの発熱度数を累積加算する発熱度数加算部と、各ブロックの前記発熱度数にもとづいて実行すべき命令をスケジューリングするスケジューラとを含む。

[0011] 本発明のさらに別の態様もプロセッサに関する。このプロセッサは、発熱制御対象となる複数のブロックの発熱度数を保持する発熱度数保持レジスタと、実行すべき命令と前記命令の実行に関わるブロックとそのブロックの発熱量に係る発熱係数とを対応づけて格納する発熱係数プロファイルと、実行すべき命令を解析して、前記命令の実行に関わる前記ブロックと前記発熱係数とを所定の命令単位で特定し、前記発熱係数プロファイルに格納するデコーダと、前記発熱係数プロファイルにもとづいて、前記命令の進行に合わせて前記所定の命令単位で前記ブロックの前記発熱度数を累積加算する発熱度数加算器と、各ブロックの前記発熱度数にもとづいて実行すべき命令をスケジューリングするスケジューラとを含む。

[0012] 本発明のさらに別の態様はマルチプロセッサシステムに関する。このマルチプロセッサシステムは、複数のサブプロセッサとメインプロセッサとを含む。前記メインプロセッサは、前記サブプロセッサ内の複数のブロックの発熱度数を保持する発熱度数保持部と、命令の実行に関わるブロックとそのブロックの発熱量に係る発熱係数とを所定の命令単位で特定する発熱特定部と、実行すべき命令の進行に合わせて前記所定の命令単位で、前記発熱特定部により特定されたブロックの前記発熱度数を前記発熱係数をもとに累積加算する発熱度数加算部と、各ブロックの前記発熱度数にもとづいて、実行すべき命令を前記複数のサブプロセッサ間で振り分けるスケジューラとを含む。

[0013] 本発明のさらに別の態様もプロセッサに関する。このプロセッサは、実行すべき命令を解読するデコーダに、前記命令の実行に関わるプロセッサ内のブロックの発熱を解析する機能をもたせる。

[0014] 本発明のさらに別の態様は温度制御方法に関する。この方法は、命令コードの進行に合わせて所定の命令単位で前記命令の実行に関わるブロックの発熱度数を累積加算してレジスタに保持することにより、命令コードの進行による発熱をブロック単位で検出する。

[0015] 本発明のさらに別の態様も温度制御方法に関する。この方法は、所定の命令単位で見積もられた発熱量をもとに、命令の進行に合わせて前記所定の命令単位で前記命令の実行に関わるブロックの発熱度数を累積加算してレジスタに保持し、前記レジスタに保持された各ブロックの前記発熱度数にもとづいて実行すべき命令をスケジューリングする。

[0016] 本発明のさらに別の態様も温度制御方法に関する。この方法は、マルチプロセッサシステムにおける各プロセッサ内のブロックの発熱量を所定の命令単位で見積もり、命令の進行によるブロックの温度変化を予測し、予測された温度変化をもとに命令を前記プロセッサ間で振り分ける。

[0017] なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。

発明の効果

[0018] 本発明によれば、プロセッサの処理性能を下げることなく、プロセッサの発熱量を抑えて動作不良を防ぐことができる。

図面の簡単な説明

[0019] [図1]実施の形態1に係るプロセッサシステムの構成図である。

[図2]図1のプロセッサシステムにおける発熱制御に係る機能構成の詳細説明図である。

[図3]図1の発熱係数プロファイルの説明図である。

[図4]図1の演算ブロック発熱度数レジスタに格納された発熱度数を説明する図である。

[図5]図1のプロセッサシステムにおける発熱制御手順を示すフローチャートである。

[図6]実施の形態2に係るプロセッサシステムの構成図である。

符号の説明

[0020] 12 命令キャッシュ、 14 命令デコーダ、 16 命令スケジューラ、 18 実行ユニット、 20 発熱係数プロファイル、 22 演算ブロック発熱度数レジスタ、 32 発熱度数加算器、 34 発熱度数減算器、 36 ホットスポット検出器、 100 CPUコ

ア、 110 メインメモリ、 200 メインプロセッサ、 210 キャッシュ、 220 DRAM
、 230a、230b サブプロセッサ。

発明を実施するための最良の形態

[0021] 実施の形態1

図1は、実施の形態1に係るプロセッサシステムの構成図である。このプロセッサシステムは、CPUコア100と、メインメモリ110とを含み、これらはアドレスバス28およびデータバス30に接続されている。CPUコア100は、メインメモリ110に対してアドレスを指定してデータの読み出しと書き込みを行う。CPUコア100は、命令キャッシュ12と、命令デコーダ14と、命令スケジューラ16と、実行ユニット18と、発熱係数プロファイル20と、演算ブロック発熱度数レジスタ22とを含む。メインメモリ110には、命令24と演算結果26が記憶される。

[0022] CPUコア100がメインメモリ110から読み出す命令24は、いったん命令キャッシュ12にキャッシュされる。命令デコーダ14は、命令キャッシュ12にキャッシュされた命令24を順次解読し、命令スケジューラ16に与える。命令スケジューラ16は、命令デコーダ14により解読された命令24間のデータ依存関係により、命令24の実行順序の並べ替えや実行タイミングの調整を行い、命令24をスケジューリングして、実行ユニット18に渡す。実行ユニット18はスケジュールされた命令24を実行し、演算結果26をメインメモリ110に書き出す。

[0023] プロセッサシステムのチップの領域全体を発熱制御対象となる小さな領域に区分けし、その小領域をブロックもしくは演算ブロックとよぶ。演算ブロックは、チップを構成するトランジスタ単体もしくはある程度の数のトランジスタの集合である。演算ブロックは、スポット的に発熱のピークが現れる領域の大きさに合わせて区切られるが、演算ブロックの大きさは、発熱制御の目標精度やプロセッサの要求仕様によって自由に決めてよい。また、また、演算ブロックは同一サイズで規則的に区切られてもよいが、各種演算ユニットの境界に合わせて不規則に区切られてもよい。

[0024] 発熱係数プロファイル20は、命令ステップ毎にその命令ステップの実行に關わるプロセッサシステムの演算ブロックとその演算ブロックの発熱量に関する発熱係数を対応づけた格納したプロファイルである。演算ブロック発熱度数レジスタ22は、各演算

ブロックの発熱度数を累積して保持するためのレジスタである。

[0025] 図2は、CPUコア100における発熱制御に係る機能構成を詳細に説明する図である。命令デコーダ14は、発熱解析機能をもち、プロセッサシステムのハードウェア情報をもとに、各命令ステップの実行に関わる演算ブロックを特定し、その演算ブロックの動作による発熱量を予測し、発熱係数を決定する。命令デコーダ14は、命令ステップ毎に特定した演算ブロックの位置情報と発熱係数を命令ステップに対応づけて発熱係数プロファイル20に格納する。

[0026] 図3は、発熱係数プロファイル20の例を説明する図である。命令ステップ40、演算ブロック位置42、および発熱係数44が対応づけられて格納されている。命令ステップ40は、命令デコーダ14によりデコードされたステップ毎の命令であり、MOV(転送)、ADD(加算)、LD(ロード)、ST(ストア)などのコマンドに引数が与えられている。たとえば、命令ステップ「MOV AX BX」は、CPUコア100の演算レジスタBXの内容を演算レジスタAXに代入する命令であり、命令ステップ「LD AX 2D」は、メインメモリ110のアドレス2DのデータをCPUコア100の演算レジスタAXにロードする命令である。

[0027] 演算ブロック位置42は、プロセッサシステムのパッケージ上のダイ(die)を矩形領域に分けた場合のマトリックスのインデックスで与えられる。発熱係数44は、演算ブロック位置42で示された領域にある演算ブロックがその命令を実行したときの発熱量の予測値から定められる数値である。

[0028] プロセッサシステムのLSIの配置配線が完了した後の論理シミュレーションにおいて、プログラムコードをシミュレートしたときの結果を利用すれば、細かい時間ステップでプロセッサのトランジスタのオンオフ状態の変化をトレースすることができる。この結果を利用すれば、命令ステップ毎にどの演算ブロックがアクティブになるかを完全に解析することができる。

[0029] 演算ブロックの発熱量については、回路設計時にCADツールなどを利用して演算ブロックの静的な温度特性を考慮して予測することができる。演算ブロックの静的な温度特性は、主として物理的な特性や素子の位置関係にもとづいて定量化される。たとえば、CMOSは値が反転するときにPチャネルとNチャネルの両トランジスタが一

瞬時にオンし、貫通電流が流れる。これがCMOSの消費電力の大半を占め、消費電力はCMOSの動作周波数に比例して増加する。このような消費電力を見積もることで演算ブロックの発熱量を予測することができる。発熱係数は発熱量の予測値を量子化した値である。回路設計時のシミュレーション結果や発熱予測量などの情報は、ハードウェア情報として命令デコーダ14から参照できるように構成される。

[0030] 図3に示す例では、命令ステップ「MOV AX BX」の実行には、(2, 3)および(2, 4)の位置の演算ブロックが関わり、発熱係数は2であり、命令ステップ「LD AX 2 D」の実行には、(2, 2)の位置の演算ブロックが関わり、発熱係数は1である。

[0031] 再び図2を参照し、命令スケジューラ16は、命令デコーダ14によりデコードされた命令24をデータ依存関係にもとづきスケジューリングし、次に実行すべき命令ステップを選択する。命令スケジューラ16は、発熱係数プロファイル20を参照して、その選択された命令ステップの実行に関わる演算ブロックの位置と発熱係数を特定し、発熱度数加算器32に与える。発熱度数加算器32は、特定された演算ブロック位置の現在の発熱度数を演算ブロック発熱度数レジスタ22から読み取り、命令スケジューラ16から与えられた発熱係数を加算して演算ブロック発熱度数レジスタ22に書き込む。

[0032] 発熱度数減算器34は、演算ブロック発熱度数レジスタ22から各演算ブロックの発熱度数を読み取り、所定の放熱定数にもとづく減算処理を行い、演算ブロック発熱度数レジスタ22に書き込む。発熱度数減算器34は、所定のクロックで動作して、演算ブロック発熱度数レジスタ22の各演算ブロックの発熱度数を減算する。これにより、時間経過による放熱量が演算ブロック発熱度数レジスタ22の発熱度数に反映される。

[0033] 発熱度数減算器34は、発熱度数がゼロになるまで減算するが、各演算ブロックの発熱度数が大きいほど発熱度数の減算量を大きく設定する。各演算ブロックの発熱度数から予測される温度と外界温度との差が大きいほど、放熱による温度低下が速いと考えられるからである。外界温度は測定値、推定値もしくはあらかじめ設定した値のいずれを用いてもよい。

[0034] 図4は、演算ブロック発熱度数レジスタ22に格納された発熱度数の例を示す。演算ブロック発熱度数レジスタ22に格納された各演算ブロックの発熱度数は、発熱度数

加算器32により命令コードの進行に合わせて累積加算され、発熱度数減算器34により時間経過とともに減算される。

[0035] 発熱度数加算器32および発熱度数減算器34は、演算ブロックの温度特性の動的な面も考慮して、演算ブロックの発熱度数を調整してもよい。演算ブロックの動的な温度特性は、主としてタスクの実行履歴や負荷状況に依存するが、場合によっては、隣接するブロックに同時にタスクが割り振られると、離れたブロックにタスクが分散する場合よりも熱が発生しやすいなどの物理的な性質からの影響も受ける。発熱度数加算器32は、演算ブロックへのタスクの割り当て状況や、隣接する演算ブロックの発熱による相互作用などを加味して発熱度数の加算を行ってもよい。発熱度数減算器34は、演算ブロックの周囲の放熱の進み具合を考慮して発熱度数の減算を行ってもよい。

[0036] 再び図2を参照し、ホットスポット検出器36は、演算ブロック発熱度数レジスタ22の発熱度数が所定の閾値を超えた演算ブロックをホットスポットとして検出し、その演算ブロックの位置を命令スケジューラ16に与える。この所定の閾値は、演算ブロックが動作不良になる限界温度よりも低い温度に対応する発熱度数で与えられる。したがって、ホットスポット検出器36は、現実にホットスポットとなった演算ブロックを検出するだけではなく、将来ホットスポットとなる可能性の高い演算ブロックもホットスポットとして検出する。

[0037] 命令スケジューラ16は、ホットスポットと判定された演算ブロックが実行に関わる命令ステップの前にウエイト命令を挿入して実行タイミングをずらしたり、ホットスポットと判定された演算ブロックが関与しない命令の実行を優先的に実行するなどの再スケジューリングを行う。このように、命令スケジューラ16は、各演算ブロックの定量化された静的／動的温度特性を評価パラメータとして利用したスケジューリングを行う。

[0038] 上記の構成では、命令デコーダ14がハードウェア情報をもとに命令ステップ毎に演算ブロックを特定し、発熱係数を決定したが、発熱係数は命令のオペランドの一部として命令コードの生成段階で埋め込まれていてもよい。たとえば、プログラマやコンパイラーが命令毎に発熱係数を指定してもよい。

[0039] 図5は、CPUコア100の命令デコーダ14と命令スケジューラ16による発熱制御手

順を示すフローチャートである。

[0040] 命令キャッシュ12に次にデコードすべき命令がキャッシュされている場合(S10のY)、命令デコーダ14は、キャッシュされた命令をデコードする(S12)。命令デコーダ14は、デコードされた命令に関わる演算ブロックを特定し、その演算ブロックの発熱係数を求め、発熱係数プロファイル20を作成する(S14)。

[0041] 命令スケジューラ16は、命令デコーダ14によりデコードされた命令をデータ依存関係にもとづいてスケジューリングする(S16)。発熱度数加算器32は、スケジュールされた命令コードの進行に合わせて、演算ブロック発熱度数レジスタ22に保持されている該当する演算ブロックの発熱度数に発熱係数を累積加算する(S18)。ここで、発熱度数加算器32は、隣接する演算ブロックとの相互作用を考慮し、隣接する演算ブロックの発熱度数が大きい場合に、当該演算ブロックの発熱度数の加算量を大きくしてもよい。

[0042] ホットスポット検出器36は、演算ブロック発熱度数レジスタ22の各演算ブロックの発熱度数を評価して温度を予測し、ホットスポットとなる演算ブロックがあるかどうか調べる(S20)。ホットスポットになる可能性の高い演算ブロックが存在する場合(S20のY)、命令スケジューラ16は、ホットスポットとなる演算ブロックが実行に関わる命令の実行を遅らせるように、命令の実行順序や実行タイミングを調整し、命令を再スケジューリングする(S22)。

[0043] 発熱度数減算器34は、時間経過による放熱量の予測値にもとづいて、演算ブロック発熱度数レジスタ22の各演算ブロックの発熱度数を減算する(S24)。以降、S10に戻り、次にデコードすべき命令がなくなる(S10のN)まで、一連の処理が繰り返される。

[0044] 本実施の形態のプロセッサシステムによれば、命令コードの進行に伴って命令ステップ毎に演算ブロック単位で発熱量を予測するため、プロセッサシステムのパッケージ全体の温度分布を時間的にも空間的にも非常に細かいレベルで正確に把握することができる。これにより、プロセッサシステムの特定の演算ブロックに処理が集中し、急峻な温度上昇が予測される場合でも、その演算ブロックが関わる命令の実行をリアルタイムでスケジューリングし、発熱のピークを回避することができる。プロセッサ全体

の処理性能を犠牲にすることなく、発熱による局所的な動作不良を防ぐことができる。

[0045] 実施の形態2

図6は、実施の形態2に係るプロセッサシステムの構成図である。本実施の形態のプロセッサシステムは、実施の形態1のCPUコア100に相当するメインプロセッサ200以外に、2つのサブプロセッサ230a、230bがバス結合したマルチプロセッサシステムである。メインプロセッサ200は、バスを介してDRAM220にアクセスしてデータを読み取り、キャッシュ210にデータをキャッシュする。メインプロセッサ200は適宜2つのサブプロセッサ230a、230bにタスクを振り分けてプログラムを実行する。

[0046] メインプロセッサ200には、実施の形態1で説明したCPUコア100の各機能構成、すなわち、命令キャッシュ12、命令デコーダ14、命令スケジューラ16、実行ユニット18、発熱係数プロファイル20、演算ブロック発熱度数レジスタ22、発熱度数加算器32、発熱度数減算器34、およびホットスポット検出器36が含まれる。以下、これらの構成について、実施の形態1とは異なる動作を説明する。

[0047] 本実施の形態のプロセッサシステムでは、メインプロセッサ200、サブプロセッサ230a、230bの各モジュールを含むプロセッサシステムのパッケージ全体の発熱量が制御対象となる。実施の形態1で述べた演算ブロックは、メインプロセッサ200、サブプロセッサ230a、230bの各モジュール内で区分けされたブロックであり、演算ブロック毎の発熱度数の加算および減算については実施の形態1と同様に行われる。

[0048] 命令スケジューラ16は、実施の形態1で述べた命令の実行順序の変更、実行タイミングの調整以外に、サブプロセッサ230a、230bに命令を振り分けることで命令のスケジューリングを行う。命令スケジューラ16によるサブプロセッサ230a、230b間の命令の振り分けは命令ステップ単位の他、サブルーチンなどある程度まとまったタスクの単位で行われてもよい。命令スケジューラ16は、サブプロセッサ230a、230bの負荷状況に応じた命令の振り分けにより、負荷分散を図るとともに、サブプロセッサ230a、230bの演算ブロックの発熱状況に応じた命令の振り分けにより、発熱量を制御する。たとえば、一方のサブプロセッサ230aにホットスポットとなる可能性の高い演算ブロックが検出された場合、命令を他方のサブプロセッサ230bに割り当てる。

[0049] 本実施の形態のプロセッサシステムによれば、各サブプロセッサ230a、230bの演

算ブロックの発熱状況に応じて、サブプロセッサ230a、230b間でタスクを割り振ることで、プロセッサシステム全体の温度分布を平準化し、プロセッサシステム内にホットスポットが生じるのを防ぐことができる。

[0050] 以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。これらの実施の形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能のこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。

[0051] そのような変形例を説明する。実施の形態では、発熱対策として、ホットスポットとなる可能性のある演算ブロックに負荷が集中しないように、命令のスケジューリングを行う方法を説明したが、これ以外の発熱対策として、たとえば、ホットスポットとなる可能性のある演算ブロックを局所的に冷却ノズルを用いて冷却する方法をとってもよい。また、命令のスケジューリングをしても演算ブロックの発熱を抑えられない場合は、プロセッサ全体の動作周波数を落としたり、電源電圧を下げるなどの緊急処置をとるよう構成してもよい。

[0052] 実施の形態では、回路設計時のシミュレータなどによりあらかじめ発熱量を見積もり、プロセッサ内に発熱係数の情報をハードウェア情報としてもたせたが、プロセッサの温度を測定するセンサを設けて、局所的に演算ブロックの温度を実測した上で、実施の形態で述べたスケジューリングによる発熱制御を実施するように構成してもよい。

[0053] 実施の形態では、命令ステップ毎に発熱量を予測し、発熱度数をカウントしたが、サブルーチンなどある程度まとまったタスク単位で発熱量を予測して、発熱度数をカウントするように構成してもよく、スケジューリングの単位も命令ステップ単位だけではなくタスク単位で行うように構成してもよい。プロセッサの各演算ブロックが比較的安全な温度範囲にあるときは、タスク単位でカウントされた発熱度数を参照してタスクスケジューリングを行い、温度が上昇してクリティカルな状況になったときは、各演算ブロックの発熱度数を命令ステップ単位でカウントして、命令単位の細かいスケジューリングを行うように切り替える切り替え制御部を設けてもよい。

[0054] 実施の形態では、発熱制御をプロセッサシステムのハードウェアで行う構成であったが、命令コードの解析と温度予測にもとづいた命令のスケジューリングとをプロセッサシステムの外部でソフトウェア処理などで行い、スケジューリングされた命令をプロ

セッサに供給する構成の命令コード生成装置をプロセッサシステムとは別に設けてよい。

[0055] アプリケーション毎に発熱特性のプロファイルを作成し、チップ上の温度センサにより実測された温度分布と照合することで発熱係数などのプロファイル情報を修正する照合部を設けてよい。これにより発熱制御の精度をさらに向上させることができる。

[0056] 実施の形態のプロセッサをメモリなどの他の素子とともに基板に搭載したプロセッサシステムを構成してもよい。また、そのようなプロセッサシステムを搭載した情報処理装置を構成してもよい。そのような情報処理装置としてパーソナルコンピュータ、各種携帯機器などがある。

産業上の利用可能性

[0057] 本発明は、プロセッサの発熱制御の分野に適用することができる。

請求の範囲

[1] 発熱制御対象となる複数のブロックの発熱度数を保持する発熱度数保持部と、命令の実行に関わるブロックとそのブロックの発熱量に係る発熱係数とを所定の命令単位で特定する発熱特定部と、実行すべき命令の進行に合わせて前記所定の命令単位で、前記発熱特定部により特定されたブロックの前記発熱度数を前記発熱係数をもとに累積加算する発熱度数加算部とを含むことを特徴とするプロセッサ。

[2] 前記発熱特定部は、実行すべき命令を解読するデコーダであることを特徴とする請求項1に記載のプロセッサ。

[3] 各ブロックの前記発熱度数を時間経過による放熱量にもとづいて減算する発熱度数減算部をさらに含むことを特徴とする請求項1または2に記載のプロセッサ。

[4] 前記発熱度数減算部は、各ブロックの前記発熱度数が大きいほど前記発熱度数の減算量を大きく設定することを特徴とする請求項3に記載のプロセッサ。

[5] 発熱制御対象となる複数のブロックの発熱度数を保持する発熱度数保持部と、所定の命令単位で見積もられた発熱量をもとに、命令の進行に合わせて前記所定の命令単位で前記命令の実行に関わるブロックの発熱度数を累積加算する発熱度数加算部と、各ブロックの前記発熱度数にもとづいて実行すべき命令をスケジューリングするスケジューラとを含むことを特徴とするプロセッサ。

[6] 前記スケジューラは、前記発熱度数が所定の閾値を超えたブロックが実行に関わる命令の実行を遅らせることを特徴とする請求項5に記載のプロセッサ。

[7] 各プロセッサの前記発熱度数を時間経過による放熱量にもとづいて減算する発熱度数減算部をさらに含むことを特徴とする請求項5または6に記載のプロセッサ。

[8] 発熱制御対象となる複数のブロックの発熱度数を保持する発熱度数保持レジスタと、実行すべき命令と前記命令の実行に関わるブロックとそのブロックの発熱量に係る発熱係数とを対応づけて格納する発熱係数プロファイルと、実行すべき命令を解析して、前記命令の実行に関わる前記ブロックと前記発熱係

数とを所定の命令単位で特定し、前記発熱係数プロファイルに格納するデコーダと、
前記発熱係数プロファイルにもとづいて、前記命令の進行に合わせて前記所定の
命令単位で前記ブロックの前記発熱度数を累積加算する発熱度数加算器と、
各ブロックの前記発熱度数にもとづいて実行すべき命令をスケジューリングするス
ケジューラとを含むことを特徴とするプロセッサ。

[9] 複数のサブプロセッサとメインプロセッサとを含むマルチプロセッサシステムであつ
て、

前記メインプロセッサは、

前記サブプロセッサ内の複数のブロックの発熱度数を保持する発熱度数保持部と
、
命令の実行に関わるブロックとそのブロックの発熱量に係る発熱係数とを所定の命
令単位で特定する発熱特定部と、

実行すべき命令の進行に合わせて前記所定の命令単位で、前記発熱特定部によ
り特定されたブロックの前記発熱度数を前記発熱係数をもとに累積加算する発熱度
数加算部と、

各ブロックの前記発熱度数にもとづいて、実行すべき命令を前記複数のサブプロセ
ッサ間で振り分けるスケジューラとを含むことを特徴とするマルチプロセッサシステム。

[10] 実行すべき命令を解読するデコーダに、前記命令の実行に関わるプロセッサ内の
ブロックの発熱を解析する機能をもたせたことを特徴とするプロセッサ。

[11] 命令コードの進行に合わせて所定の命令単位で前記命令の実行に関わるブロック
の発熱度数を累積加算してレジスタに保持することにより、命令コードの進行による
発熱をブロック単位で検出することを特徴とする温度制御方法。

[12] 所定の命令単位で見積もられた発熱量をもとに、命令の進行に合わせて前記所定
の命令単位で前記命令の実行に関わるブロックの発熱度数を累積加算してレジスタ
に保持し、前記レジスタに保持された各ブロックの前記発熱度数にもとづいて実行す
べき命令をスケジューリングすることを特徴とする温度制御方法。

[13] マルチプロセッサシステムにおける各プロセッサ内のブロックの発熱量を所定の命
令単位で見積もり、命令の進行によるブロックの温度変化を予測し、予測された温度

変化をもとに命令を前記プロセッサ間で振り分けることを特徴とする温度制御方法。

[14] 命令コードの進行に合わせて所定の命令単位で前記命令の実行に関わるブロックの発熱度数を累積加算してレジスタに保持するステップと、

前記レジスタに保持された各ブロックの前記発熱度数にもとづいて命令コードの進行による発熱をブロック単位で検出するステップとをコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。

[15] 所定の命令単位で見積もられた発熱量をもとに、命令の進行に合わせて前記所定の命令単位で前記命令の実行に関わるブロックの発熱度数を累積加算してレジスタに保持するステップと、

前記レジスタに保持された各ブロックの前記発熱度数にもとづいて実行すべき命令をスケジューリングするステップとをコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。

[16] マルチプロセッサシステムにおける各プロセッサ内のブロックの発熱量を所定の命令単位で見積もるステップと、

命令の進行によるブロックの温度変化を予測し、予測された温度変化をもとに命令を前記プロセッサ間で振り分けるステップとをコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。

[17] 命令コードの進行に合わせて所定の命令単位で前記命令の実行に関わるブロックの発熱度数を累積加算してレジスタに保持するステップと、

前記レジスタに保持された各ブロックの前記発熱度数にもとづいて命令コードの進行による発熱をブロック単位で検出するステップとをコンピュータに実行させるプログラムを格納したことを特徴とする記録媒体。

[18] 所定の命令単位で見積もられた発熱量をもとに、命令の進行に合わせて前記所定の命令単位で前記命令の実行に関わるブロックの発熱度数を累積加算してレジスタに保持するステップと、

前記レジスタに保持された各ブロックの前記発熱度数にもとづいて実行すべき命令をスケジューリングするステップとをコンピュータに実行させるプログラムを格納したことを特徴とする記録媒体。

[19] マルチプロセッサシステムにおける各プロセッサ内のブロックの発熱量を所定の命令単位で見積もるステップと、
命令の進行によるブロックの温度変化を予測し、予測された温度変化をもとに命令を前記プロセッサ間で振り分けるステップとをコンピュータに実行させるプログラムを格納したことを特徴とする記録媒体。

[20] 発熱制御対象となる複数のブロックの発熱度数を保持する発熱度数保持部と、
命令の実行に関わるブロックとそのブロックの発熱量に係る発熱係数とを所定の命令単位で特定する発熱特定部と、
実行すべき命令の進行に合わせて前記所定の命令単位で、前記発熱特定部により特定されたブロックの前記発熱度数を前記発熱係数をもとに累積加算する発熱度数加算部とを含むことを特徴とするプロセッサシステム。

[21] 発熱制御対象となる複数のブロックの発熱度数を保持する発熱度数保持部と、
所定の命令単位で見積もられた発熱量をもとに、命令の進行に合わせて前記所定の命令単位で前記命令の実行に関わるブロックの発熱度数を累積加算する発熱度数加算部と、
各ブロックの前記発熱度数にもとづいて実行すべき命令をスケジューリングするスケジューラとを含むことを特徴とするプロセッサシステム。

[22] 発熱制御対象となる複数のブロックの発熱度数を保持する発熱度数保持レジスタと、
実行すべき命令と前記命令の実行に関わるブロックとそのブロックの発熱量に係る発熱係数とを対応づけて格納する発熱係数プロファイルと、
実行すべき命令を解析して、前記命令の実行に関わる前記ブロックと前記発熱係数とを所定の命令単位で特定し、前記発熱係数プロファイルに格納するデコーダと、
前記発熱係数プロファイルにもとづいて、前記命令の進行に合わせて前記所定の命令単位で前記ブロックの前記発熱度数を累積加算する発熱度数加算器と、
各ブロックの前記発熱度数にもとづいて実行すべき命令をスケジューリングするスケジューラとを含むことを特徴とするプロセッサシステム。

[23] 実行すべき命令を解読するデコーダに、前記命令の実行に関わるプロセッサ内の

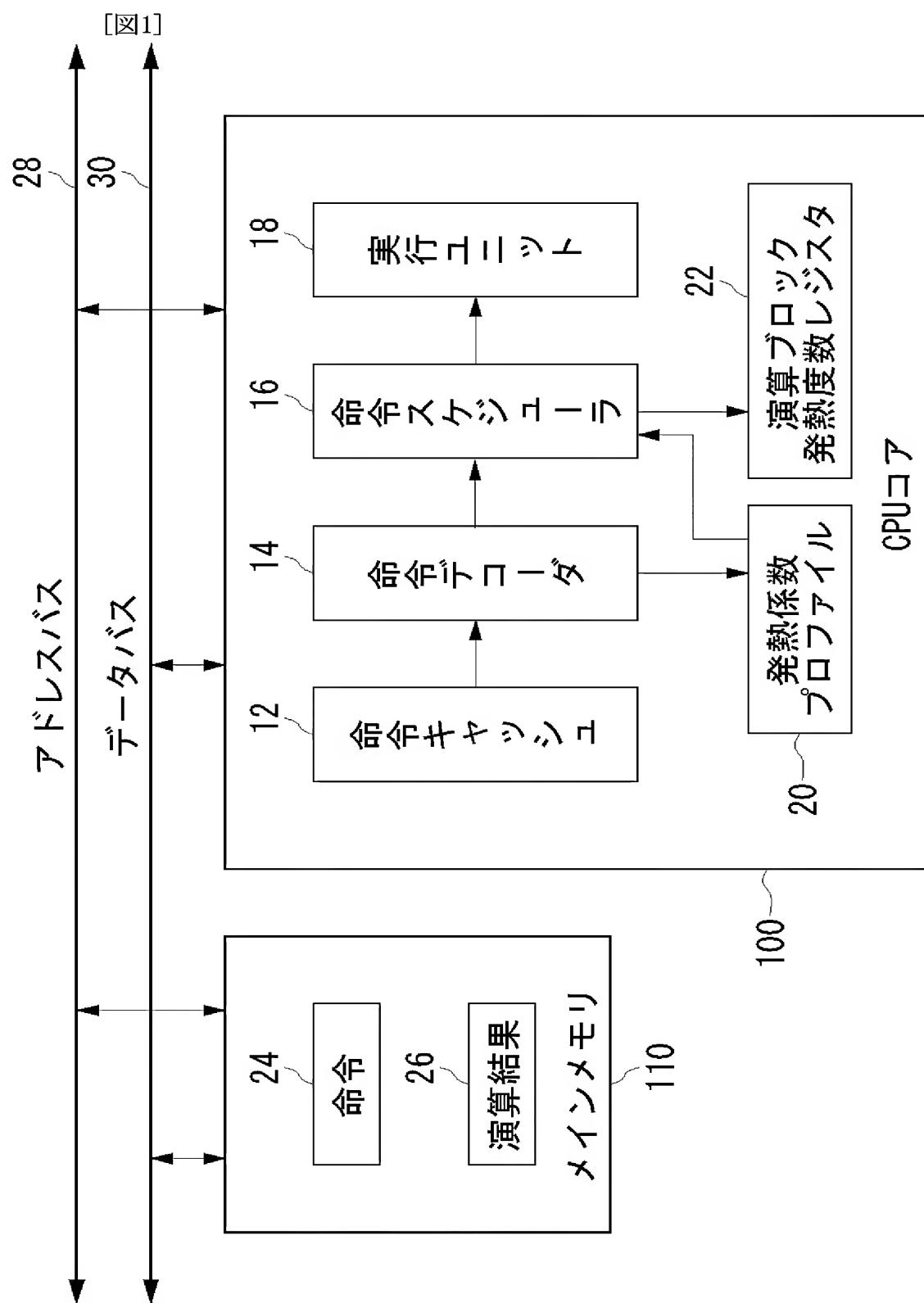
ブロックの発熱を解析する機能をもたせたことを特徴とするプロセッサシステム。

[24] 発熱制御対象となる複数のブロックの発熱度数を保持する発熱度数保持部と、命令の実行に関わるブロックとそのブロックの発熱量に係る発熱係数とを所定の命令単位で特定する発熱特定部と、
実行すべき命令の進行に合わせて前記所定の命令単位で、前記発熱特定部により特定されたブロックの前記発熱度数を前記発熱係数をもとに累積加算する発熱度数加算部とを含むことを特徴とする情報処理装置。

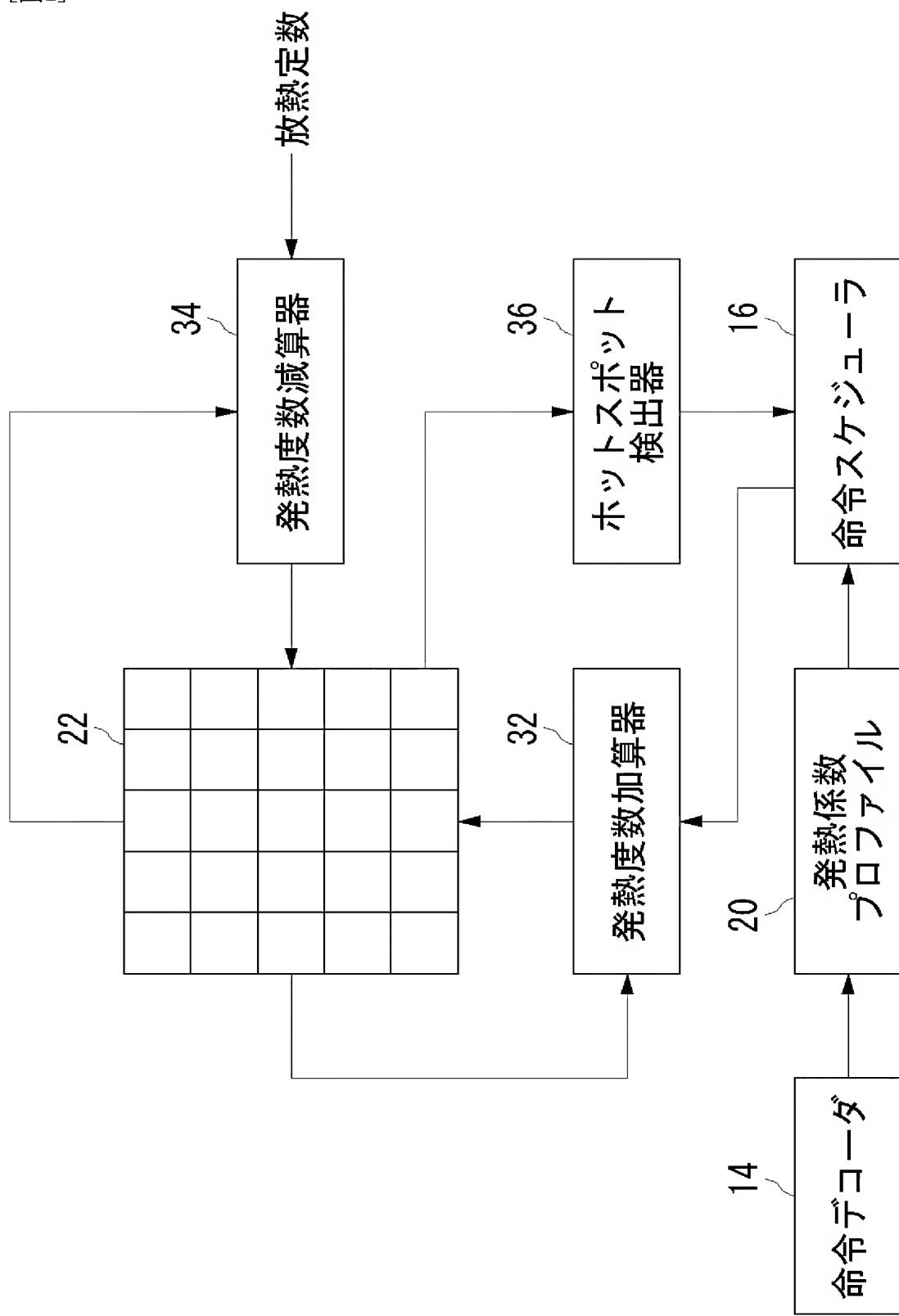
[25] 発熱制御対象となる複数のブロックの発熱度数を保持する発熱度数保持部と、
所定の命令単位で見積もられた発熱量をもとに、命令の進行に合わせて前記所定の命令単位で前記命令の実行に関わるブロックの発熱度数を累積加算する発熱度数加算部と、
各ブロックの前記発熱度数にもとづいて実行すべき命令をスケジューリングするスケジューラとを含むことを特徴とする情報処理装置。

[26] 発熱制御対象となる複数のブロックの発熱度数を保持する発熱度数保持レジスタと、
実行すべき命令と前記命令の実行に関わるブロックとそのブロックの発熱量に係る発熱係数とを対応づけて格納する発熱係数プロファイルと、
実行すべき命令を解析して、前記命令の実行に関わる前記ブロックと前記発熱係数とを所定の命令単位で特定し、前記発熱係数プロファイルに格納するデコーダと、
前記発熱係数プロファイルにもとづいて、前記命令の進行に合わせて前記所定の命令単位で前記ブロックの前記発熱度数を累積加算する発熱度数加算器と、
各ブロックの前記発熱度数にもとづいて実行すべき命令をスケジューリングするスケジューラとを含むことを特徴とする情報処理装置。

[27] 実行すべき命令を解読するデコーダに、前記命令の実行に関わるプロセッサ内のブロックの発熱を解析する機能をもたせたことを特徴とする情報処理装置。



[図2]



[図3]

20

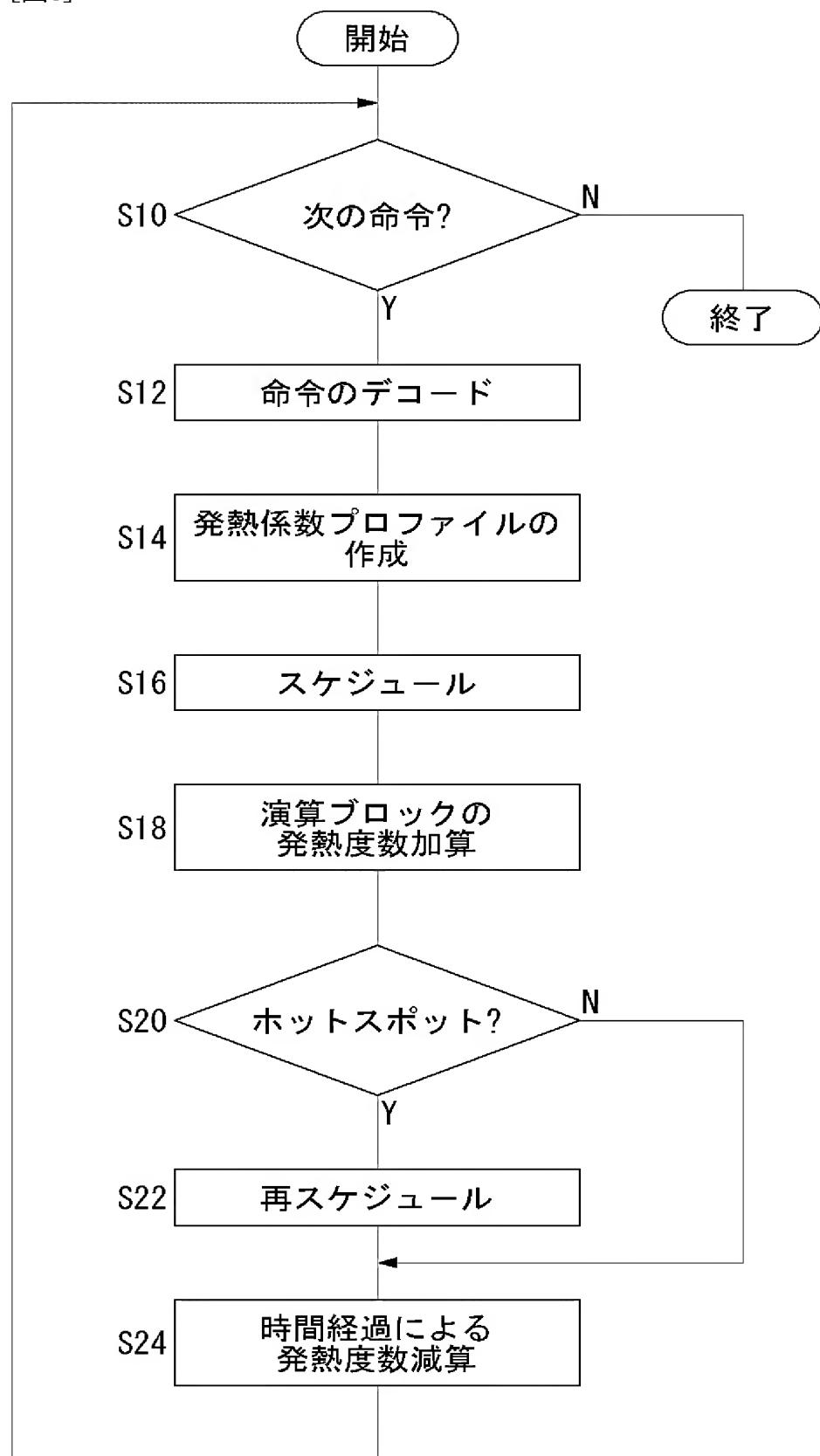
命令ステップ	演算ブロック位置	発熱係数
MOV AX BX	(2, 3), (2, 4)	2
LD AX 2D	(2, 2)	1
ADD AX 2E	(3, 1), (3, 3)	3
ST AX 2F	(4, 3)	1

[図4]

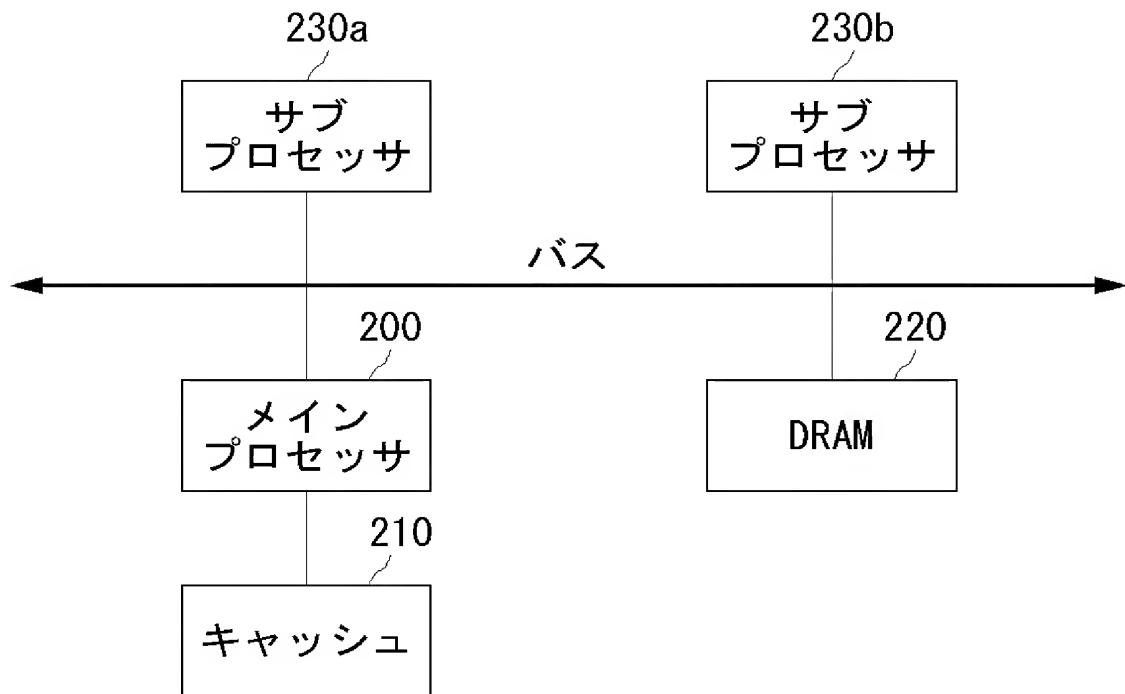
22

3	0	1	0	1
2	1	5	0	2
0	0	0	4	1
1	0	0	0	0
2	4	0	0	1

[図5]



[図6]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/019208

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 Int.Cl⁷ G06F9/50, G06F9/30

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
 Int.Cl⁷ G06F9/46-9/54, G06F9/30, G06F1/00

 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
 Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005
 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	JP 2001-229040 A (Texas Instruments Inc.), 24 August, 2001 (24.08.01), Par. Nos. [0022] to [0028], [0029], [0032] & EP 1096360 A1 & DE 69920460 E	1, 9, 20, 24 2-4
A	JP 2002-202893 A (Texas Instruments Inc.), 19 July, 2002 (19.07.02), Full text; all drawings & EP 1182538 A2	1-4, 9, 20, 24
A	WO 2003/083693 A1 (Fujitsu Ltd.), 09 October, 2003 (09.10.03), Full text; all drawings (Family: none)	1-4, 9, 20, 24

 Further documents are listed in the continuation of Box C.

 See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	
"A"	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E"	earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&"	document member of the same patent family

 Date of the actual completion of the international search
 29 March, 2005 (29.03.05)

 Date of mailing of the international search report
 26 April, 2005 (26.04.05)

 Name and mailing address of the ISA/
 Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/019208

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 7-505244 A (Seiko Epson Corp.), 08 June, 1995 (08.06.95), Full text; all drawings & US 5452401 A & WO 1993/020498 A1	1-4, 9, 20, 24
A	JP 10-240704 A (Ricoh Co., Ltd.), 11 September, 1998 (11.09.98), Full text; all drawings (Family: none)	1-4, 9, 20, 24

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/019208

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

The inventions of claims 1-4, 9, 20, 24 relate to any one of "a processor", "a multiprocessor system", "a processor system", and "an information processing device" each comprising "a heat generation frequency holding section", "a heat generation specifying section", and "a heat generation frequency adder".

The inventions of claims 5-7, 21, 25 relate to any one of "a processor", "a processor system", and "an information processing device" each comprising "a heat generation frequency holding section", "a heat generation frequency adder", and "a scheduler". (Continued to extra sheet.)

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: 1-4, 9, 20, 24

Remark on Protest

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
 No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/019208

Continuation of Box No.III of continuation of first sheet(2)

The inventions of claims 8, 22, 26 relate to any one of "a processor", "a processor system", and "an information processing device" each comprising "a heat generation frequency holding register", "a heat generation coefficient profile", "a decoder", "a heat generation frequency adder", and "a scheduler".

The inventions of claims 10, 23, 27 relate to any one of "a processor", "a processor system", and "an information processing device" "characterized in that a decoder for decoding an instruction to be executed has a function of analyzing heat generation of a block in the processor for executing the instruction".

The inventions of claims 11, 12, 14, 15, 17, 18 relate to any one of "a temperature control method" for "cumulatively adding the heat generation frequency of a block for executing instructions in each unit of instructions" and detecting heat generation of each block or scheduling the instructions to be executed according to the heat generation frequency of each block, "a program", and "a recording medium characterized by storing a program".

The inventions of claims 13, 16, 19 relate to any one of "a temperature control method" "characterized in that the amount of heat generated by the block in each processor is estimated for each instruction unit", "the variation of temperature of the block with the progress of an instruction is predicted", and "the instructions are distributed to processors according to the predicted temperature variation", "a program", and "a recording medium characterized by storing a program".

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. C1. 7 G06F9/50, G06F9/30

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C1. 7 G06F9/46-9/54, G06F9/30, G06F1/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2005年
日本国実用新案登録公報	1996-2005年
日本国登録実用新案公報	1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2001-229040 A (テキサス インスツルメンツ インコーポレイ テッド) 2001.08.24, 段落【0022】-【0028】、段落【0 029】、段落【0032】 & EP 1096360 A1 & DE 69920460 E	1, 9, 20, 24
A		2-4
A	JP 2002-202893 A (テキサス インスツルメンツ インコーポレイ テッド) 2002.07.19, 全文、全図 & EP 1182538 A2	1-4, 9, 20, 24

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
もの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日
以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する
文献(理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって
出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論
の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明
の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以
上の文献との、当業者にとって自明である組合せに
よって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 29. 03. 2005	国際調査報告の発送日 26. 4. 2005
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 殿川 雅也 5B 9646 電話番号 03-3581-1101 内線 3544

C (続き) . 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	WO 2003/083693 A1 (富士通株式会社) 2003.10.09, 全文、全図 (ファミリーなし)	1-4, 9, 20, 24
A	JP 7-505244 A (セイコーエプソン株式会社) 1995.06.08, 全文、全図 & US 5452401 A & WO 1993/020498 A1	1-4, 9, 20, 24
A	JP 10-240704 A (株式会社リコー) 1998.09.11, 全文、全図 (ファミリーなし)	1-4, 9, 20, 24

第II欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見（第1ページの2の続き）

法第8条第3項（PCT17条(2)(a)）の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. 請求の範囲 _____ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、
2. 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第III欄 発明の単一性が欠如しているときの意見（第1ページの3の続き）

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

請求の範囲1-4, 9, 20, 24に記載された発明は、「発熱度数保持部」、「発熱特定期部」、「発熱度数加算部」を備えた発明であって、「プロセッサ」、「マルチプロセッサシステム」、「プロセッサシステム」、「情報処理装置」のいずれかに関する発明である。

請求の範囲5-7, 21, 25に記載された発明は、「発熱度数保持部」、「発熱度数加算部」、「スケジューラ」を含む、「プロセッサ」、「プロセッサシステム」、「情報処理装置」のいずれかに関する発明である。

以下、特別ページに続く。

1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

請求の範囲1-4, 9, 20, 24

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあつた。
- 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかつた。

(第III欄のつづき)

請求項8, 22, 26に記載された発明は、「発熱度数保持レジスタ」、「発熱係数プロファイル」、「デコーダ」、「発熱度数加算器」、「スケジューラ」を含む、「プロセッサ」、「プロセッサシステム」、「情報処理装置」のいずれかに関する発明である。

請求項10, 23, 27に記載された発明は、「実行すべき命令を解読するデコーダに、前記命令の実行に関わるプロセッサ内のブロックの発熱を解析する機能をもたせたことを特徴」とする、「プロセッサ」、「プロセッサシステム」、「情報処理装置」のいずれかに関する発明である。

請求項11, 12, 14, 15, 17, 18に記載された発明は、「所定の命令単位で前記命令の実行に関わるブロックの発熱度数を累積加算」し、発熱をブロック単位で検出するか、又は、各ブロックの発熱度数に基づいて実行すべき命令をスケジューリングする、「温度制御方法」、「プログラム」、「プログラムを格納したことを特徴とする記録媒体」のいずれかに関する発明である。

請求項13, 16, 19に記載された発明は、「各プロセッサ内のブロックの発熱量を所定の命令単位で見積もり」、「命令の進行によるブロックの温度変化を予測し」、「予測された温度変化をもとに命令を前記プロセッサ間で振り分けることを特徴」とする、「温度制御方法」、「プログラム」、「プログラムを格納したことを特徴とする記録媒体」のいずれかに関する発明である。